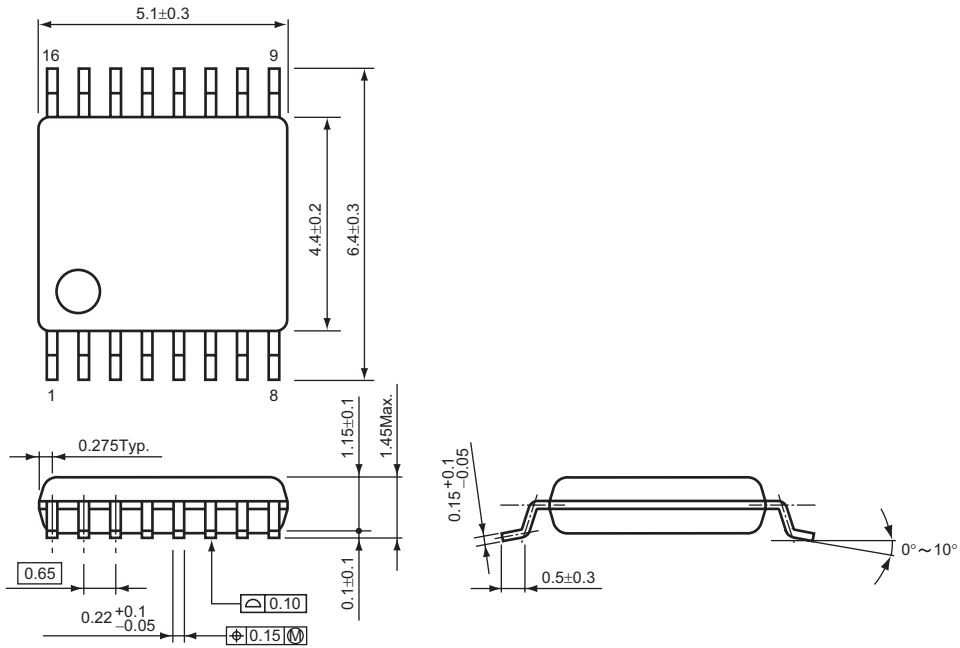


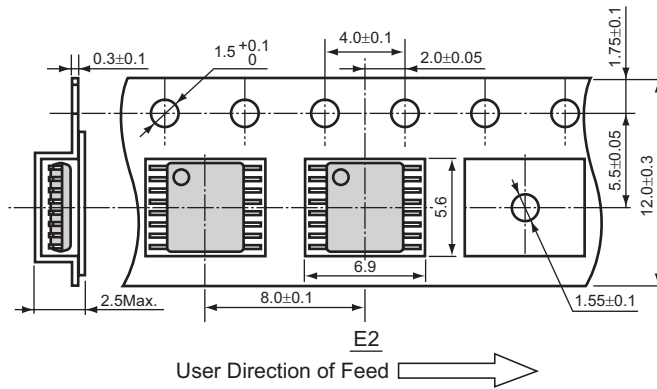
SSOP-16

単位 : mm

■ パッケージ外形図

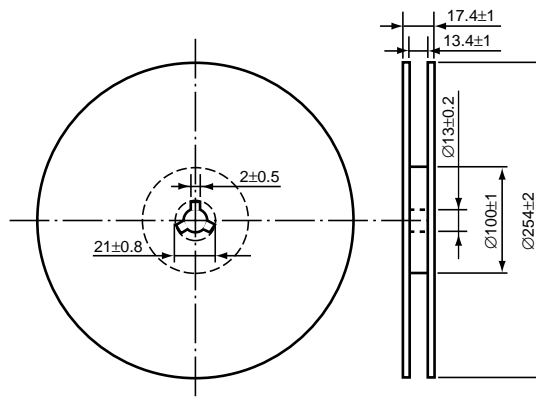


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール(EIAJ-RRM-12Cc)

(1 リール=2,000 個)



### ■ 許容損失について (SSOP-16)

SSOP-16パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

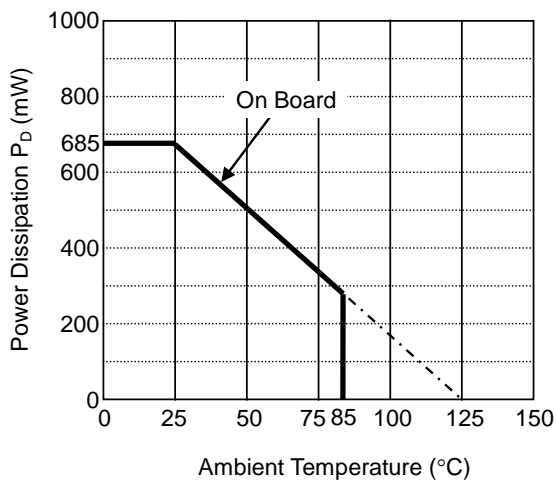
測定条件

	標準実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.5mm × 44個

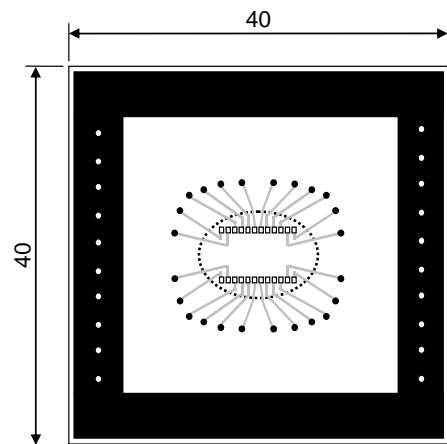
測定結果

(Topt=25°C, Tjmax=125°C)

	標準実装条件
許容損失	685mW
熱抵抗値	$\theta_{ja}=(125-25^\circ\text{C})/0.685\text{W}=146^\circ\text{C/W}$
熱抵抗値	$\theta_{jc}=22^\circ\text{C/W}$



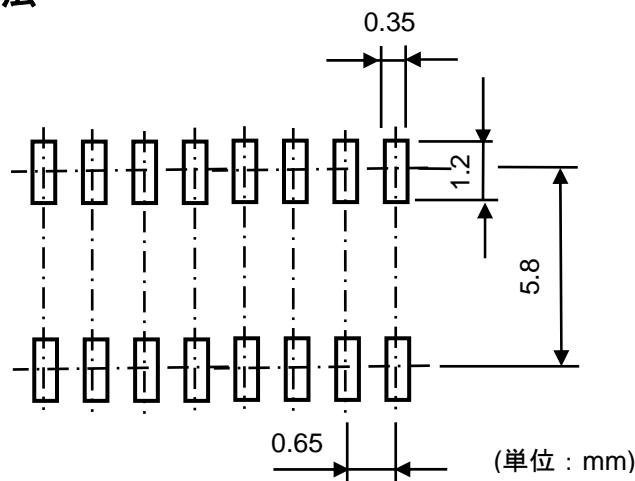
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

### ■ 基板パッド推奨寸法



(単位 : mm)